

技術資料

FeedBond® AP-1200-A2

絕緣膠

產品說明：

AP-1200-A2 是一種單組分、無氣孔、低溢流、低內應力、非導電環氧樹脂混合接著劑，專為無鉛 PBGA 和陣列 BGA 半導體晶片貼裝而設計。可用於各種尺寸的晶片。適用於點膠應用。

產品特徵：

- 低模量。
- 可烘箱固化或隧道式快速固化。
- 優良的點膠特性，不拖絲拉尾
- 優良的封裝可靠性

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	紅色		
黏度 @ 25°C	12000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	4.5	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
使用壽命 @ 25°C	24hrs	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C	12 個月		FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		15 分鐘 @175°C	
其他烘烤條件		升溫速率:5°C/min 至 175°C+15 分鐘 @175°C	
硬化時之熱重損失	3.0%	TGA	FT-P010
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	>7 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (Ag/Cu LF)	FT-M012
@ 25°C	10 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (SM/BT)	

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

AP-1200-A2 導電銀膠

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	15°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數	<Tg 90ppm/°C >Tg 175ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數			
@-40°C	1550MPa		
@25°C	460MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@150°C	49MPa		
@250°C	57MPa		
離子			
Cl-	<10 ppm	特氟龍燒瓶，20~40 目，50 克去離子水中 5g 樣品，24 小時@100°C	FTC-021
Na+	<10 ppm		
K+	<10 ppm		
重量損失@200°C	<1%	熱重分析儀	FT-P010
熱裂解溫度	400°C	熱重分析儀	FT-P010
吸濕率	1.2%	5 °C/85%RH 恆溫恆濕測試	FT-P032
熱/電性質		測試條件	測試方法
熱傳導係數	0.2W/mK	Hot Disk	FT-P022

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間60鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C或-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）